

## FFP D1/80H S1 B TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## OMNIMATE® 보드 투 보드(Board-to-Board) 커넥터

컴팩트한 장치의 유연한 엔지니어링

미래 대비형 컨텍트 시스템의 사용과 제조 공정의 최적화는 효율적인 산업용 장치의 개발, 특히 Industry 4.0 분야에서 그 중요성이 날로 커지고 있습니다. OMNIMATE® 보드 투 보드 커넥터는 피치 1.27mm로, 각기 다른 설계에 대해 최대한의 유연성을 제공합니다.

- 유연한 장치 설계 - 산업 용도로 적합한 밀도와 고도의 유연성을 가진 결선 조합의 만남 (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card, Cable-to-Board)
- 자동화 준비 완료 - 고정밀 핀 동일평면성 및 SMT 고정 기능을 갖춘 자동 조립 용도로 개발
- 신뢰도 높은 접점 - 산업용 적합 금도금(PdNi-Au)을 적용해 체결 주기 최대 500회
- 공정 준비 완료 - 리플로우 솔더링을 위한 고성능 LCP 소재
- 확장성 - 높이가 각기 다르고 고접점 중첩이 있어 12~80개 폴까지 다양한 솔루션을 보장합니다.
- 활용도 높은 소형화 - 경사 또는 오프셋 등, 까다로운 체결 조건에서도 간편하고 안전한 결선 가능.

## 일반 주문 데이터

버전	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 피치(mm)(P): 1.27 mm, 극 수: 80, 트레이 (수작업 조립)
주문 번호	<a href="#">2747600000</a>
유형	FFP D1/80H S1 B TY
GTIN (EAN)	4050118896176
수량	50 items
제품 데이터	IEC: / 1.9 A UL: 150 V / 1 A / AWG 30 sol - AWG 30 sol
파키징	트레이 (수작업 조립)

## FFP D1/80H S1 B TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인	
ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cURus)	E92202

## 치수 및 중량

깊이	5.6 mm	깊이 (인치)	0.2205 inch
높이	14.05 mm	높이 (인치)	0.5531 inch
너비	58.58 mm	폭 (인치)	2.3063 inch
순중량	6.6 g		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 시스템 매개변수

제품군	OMNIMATE 신호 - 보드 투 보드	결선 유형	절연 변위 결선(IDC)
와이어 결선 방식	IDC 단자	피치(mm)(P)	1.27 mm
피치(인치)(P)	0.050 "	도체 아웃렛 방향	90°/270°
극 수	80	행 수	1
핀 시리즈 수량	2	보호 등급	IP20
볼륨 저항	<25 mΩ	플러그 주기	500
플러깅 힘/풀, 최대	0.6 N	당기는 힘 / 풀, 최대	0.6 N

## 자재 데이터

절연재	LCP	컬러 코드	검정
컬러 차트(유사)	RAL 9011	절연재 그룹	IIIa
절연 저항	$\geq 10^{10} \Omega$	Moisture Level (MSL)	1
UL 94 가연성 등급	V-0	접점 기본 재질	구리 합금
접점 재질	구리 합금	접점 표면	Ni/Au
플러그 접점의 레이어 구조	$\geq 2 \mu\text{m Ni} / \geq 0.4 \mu\text{m PdNi} / \geq 0.05 \mu\text{m Au}$	보관 온도, 최소	-40 °C
보관 온도, 최대	70 °C	작동 온도, 최소	-55 °C
작동 온도, 최대	125 °C		

## 결선에 적합한 컨ектор

결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 30/1, 30/7	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 30/1, 30/7
절연재의 외부 직경, 최소	0.55 mm	절연재 외경, 최대	0.75 mm

## IEC 정격데이터

정격 전류, 극 수( $T_u=20^\circ\text{C}$ )	1.9 A	정격 전류, 최대 극 수( $T_u=20^\circ\text{C}$ )	2.3 A
정격 전류, 극 수( $T_u=40^\circ\text{C}$ )	2.5 A	연면거리, 분	0.4 mm
최소간격, 분	0.4 mm		

## FFP D1/80H S1 B TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## UL 1977에 따른 정격 데이터

승인값 참조	사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조	정격 전압(UL 1977)(구형)	150 V
정격 전류(UL 1977)(구형) AWG 컨덕터, 최대(UL 1977)	1 A 30 sol	AWG 컨덕터, 최소(UL 1977)	30 sol

## 패키징

패키징	트레이 (수작업 조립)	VPE 길이	189.00 mm
VPE 폭	131.00 mm	VPE 높이	70.00 mm

## 중요 참고 사항

IPC 준수	적합성: 본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.
--------	---

## 참고 사항

## 분류

ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		

**FFP D1/80H S1 B TY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

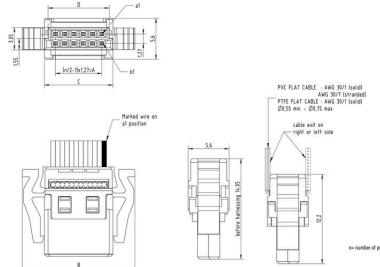
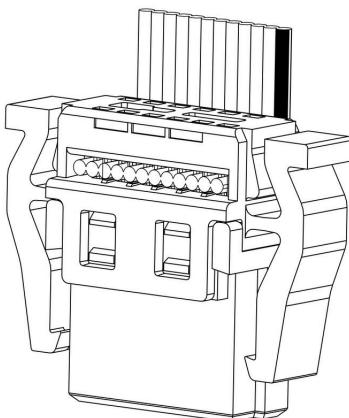
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**도면**

With optional strain relief

**Dimensional drawing**

Type	Order no.	No. of poles	A	B	C	D	E
FFP D1/2H S1 B TY	2741520000	12	8,35	15,4	0,37	8,37	15
FFP D1/2H S1 B TY	2741530000	16	8,85	17,1	1,03	10,17	15
FFP D1/2H S1 B TY	2741540000	20	11,63	20,43	14,45	13,45	15
FFP D1/2H S1 B TY	2741550000	26	15,24	24,29	18,26	17,26	15
FFP D1/2H S1 B TY	2741560000	32	19,85	28,1	22,05	21,05	15
FFP D1/2H S1 B TY	2741570000	40	24,43	33,18	27,75	26,75	15
FFP D1/2H S1 B TY	2741580000	50	30,48	39,53	33,5	32,5	15
FFP D1/2H S1 B TY	2741590000	68	41,93	50,98	44,03	43,93	16,2
FFP D1/2H S1 B TY	2741600000	80	48,53	58,58	50,88	51,08	16,2

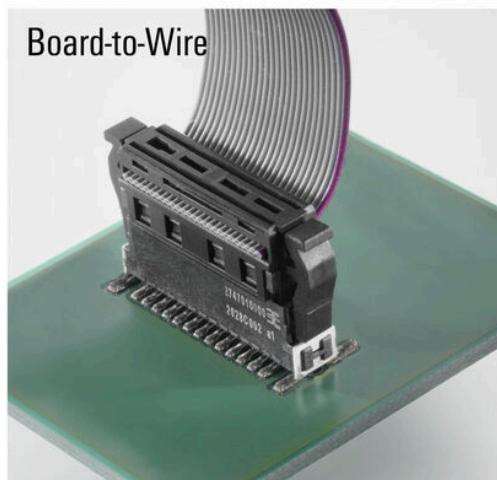
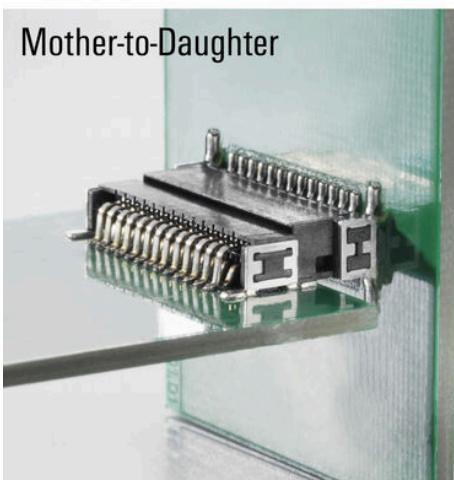
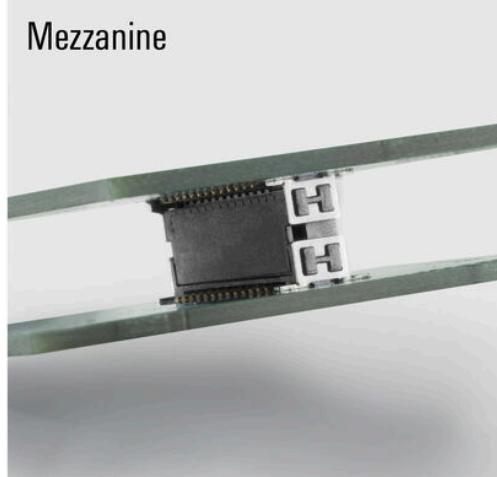
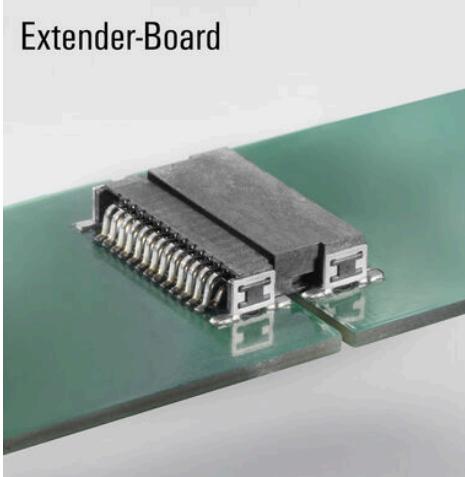
**상세 도면**

**FFP D1/80H S1 B TY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면



## FFP D1/80H S1 B TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## FC/FFP - 스트레인 릴리프(액세서리)



OMNIMATE® 보드 투 보드(Board-to-Board) 커넥터  
컴팩트한 장치의 유연한 엔지니어링  
미래 대비형 컨텍트 시스템의 사용과 제조 공정의 최적화는  
효율적인 산업용 장치의 개발, 특히 Industry 4.0 분야에서  
그 중요성이 날로 커지고 있습니다. OMNIMATE® 보드  
투 보드 커넥터는 피치 1.27mm로, 각기 다른 설계에 대해  
최대한의 유연성을 제공합니다.

- 유연한 장치 설계 - 산업 용도로 적합한 밀도와 고도의  
유연성을 가진 결선 조합의 만남 (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card, Cable-to-Board)
- 자동화 준비 완료 - 고정밀 핀 동일평면성 및 SMT 고정  
기능을 갖춘 자동 조립 용도로 개발
- 신뢰도 높은 접점 - 산업용 적합 금도금(PdNi-Au)을  
적용해 체결 주기 최대 500회
- 공정 준비 완료 - 리플로우 솔더링을 위한 고성능 LCP  
소재
- 확장성 - 높이가 각기 다르고 고접점 중첩이 있어  
12~80개 폴까지 다양한 솔루션을 보장합니다.
- 활용도 높은 소형화 - 경사 또는 오프셋 등, 까다로운 체결  
조건에서도 간편하고 안전한 결선 가능.

## 일반 주문 데이터

유형	FC/FFP ZE/80 B BX	버전
주문 번호	<a href="#">2853190000</a>	PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 피치(mm)(P): 1.27 mm, 극 수: 80,
GTIN (EAN)	4064675476047	90°, 180°, 270°, 박스
수량	50 ST	

## FFP D1/80H S1 B TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 대응물

## FMH - 수형 헤더, 보드 결선



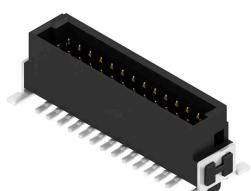
OMNIMATE® 보드 투 보드(Board-to-Board) 커넥터  
컴팩트한 장치의 유연한 엔지니어링  
미래 대비형 컨텍트 시스템의 사용과 제조 공정의 최적화는  
효율적인 산업용 장치의 개발, 특히 Industry 4.0 분야에서  
그 중요성이 날로 커지고 있습니다. OMNIMATE® 보드  
투 보드 커넥터는 피치 1.27mm로, 각기 다른 설계에 대해  
최대한의 유연성을 제공합니다.

- 유연한 장치 설계 - 산업 용도로 적합한 밀도와 고도의  
유연성을 가진 결선 조합의 만남 (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card, Cable-to-Board)
- 자동화 준비 완료 - 고정밀 핀 동일평면성 및 SMT 고정  
기능을 갖춘 자동 조립 용도로 개발
- 신뢰도 높은 접점 - 산업용 적합 금도금(PdNi-Au)을  
적용해 체결 주기 최대 500회
- 공정 준비 완료 - 리플로우 솔더링을 위한 고성능 LCP  
소재
- 확장성 - 높이가 각기 다르고 고접점 중첩이 있어  
12~80개 폴까지 다양한 솔루션을 보장합니다.
- 활용도 높은 소형화 - 경사 또는 오프셋 등, 까다로운 체결  
조건에서도 간편하고 안전한 결선 가능.

## 일반 주문 데이터

유형	FMH S1/80H F1 B RL	버전
주문 번호	<a href="#">2747240000</a>	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, SMD 용접 결선, 피치(mm)(P): 1.27
GTIN (EAN)	4064675000983	mm, 극 수: 80, 90°, Tape
수량	560 ST	

## FMH1 - 수형 헤더, 보드 결선(스택 높이 1.75mm)



OMNIMATE® 보드 투 보드(Board-to-Board) 커넥터  
컴팩트한 장치의 유연한 엔지니어링  
미래 대비형 컨텍트 시스템의 사용과 제조 공정의 최적화는  
효율적인 산업용 장치의 개발, 특히 Industry 4.0 분야에서  
그 중요성이 날로 커지고 있습니다. OMNIMATE® 보드  
투 보드 커넥터는 피치 1.27mm로, 각기 다른 설계에 대해  
최대한의 유연성을 제공합니다.

- 유연한 장치 설계 - 산업 용도로 적합한 밀도와 고도의  
유연성을 가진 결선 조합의 만남 (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card, Cable-to-Board)
- 자동화 준비 완료 - 고정밀 핀 동일평면성 및 SMT 고정  
기능을 갖춘 자동 조립 용도로 개발
- 신뢰도 높은 접점 - 산업용 적합 금도금(PdNi-Au)을  
적용해 체결 주기 최대 500회
- 공정 준비 완료 - 리플로우 솔더링을 위한 고성능 LCP  
소재
- 확장성 - 높이가 각기 다르고 고접점 중첩이 있어  
12~80개 폴까지 다양한 솔루션을 보장합니다.
- 활용도 높은 소형화 - 경사 또는 오프셋 등, 까다로운 체결  
조건에서도 간편하고 안전한 결선 가능.

## 일반 주문 데이터

유형	FMH1 S1/80V F1 B RL	버전
주문 번호	<a href="#">2747060000</a>	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, SMD 용접 결선, 피치(mm)(P): 1.27
GTIN (EAN)	4064675001195	mm, 극 수: 80, 180°, Tape
수량	280 ST	

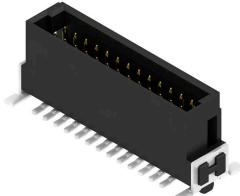
## FFP D1/80H S1 B TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 대응물

## FMH3 - 수형 헤더, 보드 결선(스택 높이 3.25mm)



OMNIMATE® 보드 투 보드(Board-to-Board) 커넥터  
컴팩트한 장치의 유연한 엔지니어링  
미래 대비형 컨텍트 시스템의 사용과 제조 공정의 최적화는  
효율적인 산업용 장치의 개발, 특히 Industry 4.0 분야에서  
그 중요성이 날로 커지고 있습니다. OMNIMATE® 보드  
투 보드 커넥터는 피치 1.27mm로, 각기 다른 설계에 대해  
최대한의 유연성을 제공합니다.

- 유연한 장치 설계 - 산업 용도로 적합한 밀도와 고도의  
유연성을 가진 결선 조합의 만남 (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card, Cable-to-Board)
- 자동화 준비 완료 - 고정밀 핀 동일평면성 및 SMT 고정  
기능을 갖춘 자동 조립 용도로 개발
- 신뢰도 높은 접점 - 산업용 적합 금도금(PdNi-Au)을  
적용해 체결 주기 최대 500회
- 공정 준비 완료 - 리플로우 솔더링을 위한 고성능 LCP  
소재
- 확장성 - 높이가 각기 다르고 고접점 중첩이 있어  
12~80개 폴까지 다양한 솔루션을 보장합니다.
- 활용도 높은 소형화 - 경사 또는 오프셋 등, 까다로운 체결  
조건에서도 간편하고 안전한 결선 가능.

## 일반 주문 데이터

유형	FMH3 S1/80V F1 B RL	버전
주문 번호	<a href="#">2747150000</a>	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, SMD 용접 결선, 피치(mm)(P): 1.27
GTIN (EAN)	4064675001096	mm, 극 수: 80, 180°, Tape
수량	280 ST	